



聲明書編號 TW22/00456CFP

碳足跡查證聲明書

查證標的服務
晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務

以上服務碳足跡計算之提供者為

台星科技股份有限公司

307 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰 176-5 號

本公司確認以生命週期評估數據為基礎
依據 ISO 14064-3:2006 完成查證並符合下列標準要求

ISO 14067:2018

生命週期評估範疇

企業對企業

簽署人

鮑柏宇

知識與管理事業群副總經理

版次:1

聲明書發證日期：2022年11月11日

聲明書有效日期：2024年11月10日

TGP57-15-23 2207

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

t(02)22993279 f(02)22999453

<http://www.sgs.com>

